

## SIPLACE V

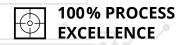
Die neue Ära der Bestücktechnik

## SIPLACE V BOOSTS YOUR INTELLIGENT FACTORY











#### Leistungsstark. Präzise. Zukunftssicher.

Die SIPLACE V Plattform ist mehr als nur die nächste Generation von Bestückautomaten. Sie bietet Leistungssteigerungen von bis zu 30 Prozent – und das unter realen Produktionsbedingungen.

Sie markiert den Beginn einer neuen Ära in puncto Flächenleistung, Flexibilität, Qualität und Investitionssicherheit.

Vollständig kompatibel mit bestehenden Maschinen, Feedern und Softwarelösungen von ASMPT ist sie perfekt gerüstet für Big Data Processing, KI und Automatisierung – und damit konsequent auf die Zukunft ausgerichtet.



### FIT FÜR DIE SCHLÜSSEL-BRANCHEN DER ZUKUNFT



#### Elektronikfertigungen sind so vielfältig wie ihre Produkte – doch eines verbindet sie alle: der Anspruch an höchste Qualität, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.

Die neue SIPLACE V wurde genau dafür entwickelt. Sie passt sich nahtlos an unterschiedlichste Produktionsumgebungen an und überzeugt mit Präzision, Stabilität und Effizienz – unabhängig von Stückzahlen, Produktarten oder Komplexität. Ihre besonderen Stärken zeigt sie vor allem in den Schlüsselbranchen der Zukunft, in denen Leistung, Prozesssicherheit und Investitionsschutz über den Erfolg entscheiden.

**Automobilindustrie:** Im Automotive-Bereich entstehen Steuer- und Leistungselektronik unter höchsten Anforderungen an Qualität, Prozesssicherheit und Rückverfolgbarkeit. Nacharbeit ist keine Option, die Null-Fehler-Strategie ist Standard. Die SIPLACE V bietet die Flexibilität und Prozesssicherheit, die diese Branche verlangt.

**Consumer-Elektronik:** Hohe Produktionsvolumina, kurze Taktzeiten und maximale Linienauslastung prägen den Consumer-Bereich. Die SIPLACE V überzeugt hier mit höchsten Bestückraten, stabiler Real Performance und schnellen Produktwechseln für maximale Overall Equipment Effectiveness bei geringen Betriebskosten.

**Smartphone:** Im Smartphone-Bereich zählen Geschwindigkeit, Präzision und Prozessstabilität. Die SIPLACE V bestückt hochintegrierte, dicht bepackte Leiterplatten mit komplexen Layouts und Spezialbauelementen – von 016008M bis zu großformatigen Odd-Shaped Components – mit höchster Genauigkeit.

**IT & Netzwerk-Infrastruktur:** Großformatige Leiterplatten, komplexe Designs und hybride Signalübertragung zwischen Elektronik und Optik stellen hohe Anforderungen an die Bestücktechnik. Die SIPLACE V bietet die nötige Flexibilität und Präzision für diese Anwendungen.

## 30% MORE REAL PERFORMANCE **SPÜRBAR UND MESSBAR**

## Neue Maßstäbe in Geschwindigkeit und Flächenproduktivität

- Komplett neu entwickelte Plattform: Verstärkte Rahmen- und Verbindungselemente sorgen für maximale Stabilität.
- Hocheffiziente Linearantriebe: Ermöglichen höhere Beschleunigungen auf den Hauptachsen und optimierte Verfahrwege für maximale Bestückleistung.
- Optimierte Bestückkopfgeneration: Weiterentwickelte Bestückköpfe mit hochauflösenden Kamerasystemen ermöglichen höhere Geschwindigkeit und Präzision.
- **Herausragende Flächenproduktivität:** Mehr Leistung pro Quadratmeter dank kompakter Bauweise und optimaler Raumausnutzung bei einem Footprint von nur 1,1 × 2,4 Metern.
- Nachgewiesene Performance: Unter realen Produktionsbedingungen erreicht die SIPLACE V bis zu 30 % höhere Leistung in Schlüssel- und Zukunftsmärkten.



Spitzenleitung von bis zu 52.500 BE/h auf kompaktem Footprint von nur 1,1 × 2,4 Metern.

## 100% PROCESS EXCELLENCE **QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE**

#### Maximale Präzision und konstante Prozesssicherheit in jedem Detail

- Maximale Präzision: Neue Linearantriebe und hochauflösende Messsysteme ermöglichen exakte Platzierungen bis 25 μm @ 3σ.
- Intelligente Sensorik: Closed-Loop-Regelung passt die Bestückkraft in Echtzeit an und sorgt für gleichbleibend hohe Qualität bei jedem Bauelement.
- **Perfekte Ausrichtung:** Die einzigartigen, drehbaren Pipettensegmente von ASMPT gewährleisten präzise Winkellagen und fehlerfreie Bestückung.
- Automatisierte Qualitätssicherung: Hochauflösende Kameras prüfen jedes Bauelement; variable Abholpositionen und Leiterplattenverwölbungen werden automatisch kompensiert.
- Lückenlose Traceability: Komplette Rückverfolgbarkeit aller Komponenten ideal für Automotive- und High-Reliability-Anwendungen.
- **Prozesssicherheit bei komplexen Bauelementen:** Automatischer Smart Pin Support und verbesserte OSC-Verarbeitung garantieren stabile Ergebnisse auch bei Sonderkomponenten.



Smart Pin Support verhindert das Durchbiegen von Leiterplatten an kritischen Punkten.



Drehbare Pipettensegmente richten Bauelemente bereits beim Aufnehmen präzise aus.

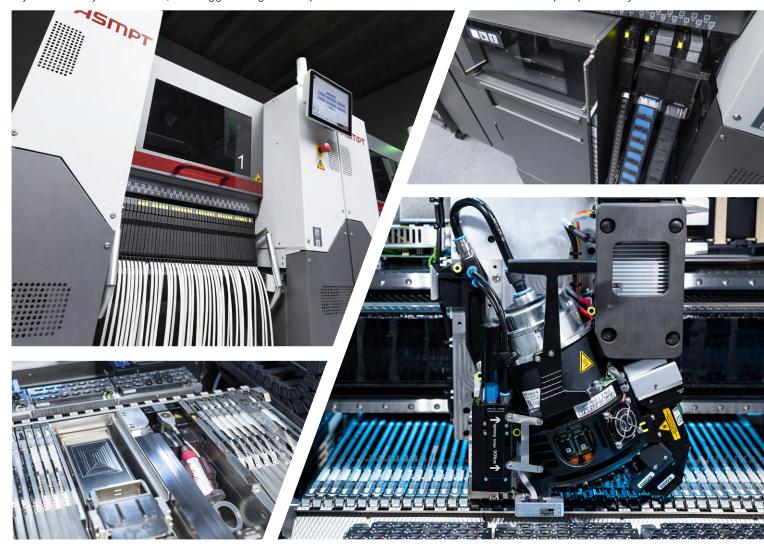
# UNLIMITED FLEXIBILITY FÜR JEDE FERTIGUNG

#### Highspeed, Mischbestückung oder Sonderbauelemente – für jede Anforderung die passende Lösung

- Umfassendes Bauelementspektrum: Die SIPLACE V beherrscht das gesamte Bauelementspektrum von ultrakleinen 016008M-Chips bis zu großformatigen Odd-Shaped Components (OSCs) inklusive BGAs.
- Drei optimierte Bestückköpfe: Für jede Fertigungsanforderung die optimale Wahl. Der Wechsel erfolgt dank universeller Kopfschnittstelle einfach und schnell – auch im laufenden Betrieb.
- Erweiterte Feeder-Kapazität: Bis zu 45 × 8-mm-Feeder je Seite sind unabhängig von gewählten Optionen nutzbar. Kompatibel mit allen SIPLACE X Feedern sowie Linear Dipping Unit, Power Connector, Glue Feeder und Measuring Feeder.
- Flexibles Transportsystem: Einfach- oder Doppeltransport für unterschiedliche Leiterplattengrößen und Produktionsanforderungen.
- Variable Maschinenkonfiguration: Ein- oder Zweiportal-Version, Einfach- und Doppeltransport, optionales 3D-Koplan-Modul und zusätzliche Kameras bieten maximale Anpassungsfähigkeit für jede Fertigungslinie.

45 freie 8-mm-Slots je Seite – konstant, unabhängig von den gewählten Optionen.

Neue schlanke und platzsparende Tray Unit V.



Volle Kompatibilität mit allen SIPLACE X Feedern, Linear Dipping Unit, Power Connector, Glue und Measuring Feeder. Bestückkopf CP20: Highspeed-Collect-and-Place-Bestückkopf mit bis zu 52.500 BE/h bei 25 μm @ 3σ Bestückgenauigkeit.

### READY FOR THE FUTURE

### BEREIT FÜR ALLES, WAS KOMMT

#### Die SIPLACE V verbindet heutige Spitzenleistung mit echter Zukunftsfähigkeit

- Offene Systemarchitektur: Von Grund auf modular konzipiert und vorbereitet für kommende Bestückkopfgenerationen sowie zukünftige Prozessanforderungen.
- Highspeed-Datenkommunikation: Gigabit-Ethernet sorgt für maximale Bandbreite, minimale Latenz, nahtlose M2M-Kommunikation und effizientes Big-Data-Management inklusive Analysefunktionen.
- **KI- und Datenanalysefähig:** Ein integratives Datenkonzept bildet die Basis für KI-gestützte Prozessoptimierung und vorausschauende Qualitätskontrolle.
- Automation Ready: Bereits heute ausgelegt für autonome Feeder-Zuführung und weitere Automatisierungsschritte in der Elektronikfertigung.
- Zukunftsichere Investition: Die SIPLACE V ist wie alle Lösungen von ASMPT – vollständig kompatibel mit bestehenden Maschinen, Feedern und dem gesamten ASMPT Softwareportfolio.

## Softwareintegration – die Basis für intelligente Fertigungsprozesse.

ASMPT bietet leistungsstarke Softwarelösungen für alle Ebenen der Elektronikfertigung – von der Maschinen- über die Linien- und Shopfloor- bis hin zur Enterprise-Ebene. Sie vernetzen Prozesse, steigern Transparenz und Effizienz und unterstützen Hersteller aktiv auf ihrem Weg zur durchgängig digitalisierten, intelligenten Fertigung der Zukunft.

- WORKS Software Suite: WORKS Applikationen bringen Produktionslinien in Bestform, entlasten Mitarbeitende, steuern Produktionsabläufe und Materialflüsse effizient und transparent. Offene Schnittstellen ermöglichen die einfache Anbindung von MES- und ERP-Lösungen.
- Factory Solutions: Mit den Factory Solutions unterstützt ASMPT die intelligente Intralogistik, das Asset- und Wartungsmanagement sowie die Prozessanalyse an der SMT-Linie. KI-gestützte Assistenzsysteme helfen bei Entscheidungen in Echtzeit, erhöhen die Anlagenverfügbarkeit und verbessern kontinuierlich Qualität und Produktivität.

Die offenen Standards IPC-LFX sichern
fertigungsweite, durchgängige M2M- und M2H-Kommunikation.

CEX.

ENTERPRISE LEVEL

LUNE LEVEL

MACHINE LEVEL

MACHINE LEVEL

WORKS Software Suite – die Plattform für die intelligente Fertigung; effiziente
Abloufe, autonome Prozessoptimierung und nöhtlöse Systemintegration.

# SIPLACE V **TECHNISCHE DATEN**



Technische Daten	SIPLACE V		
Bestückleistung (Benchmark)	105.000 BE/h		
Maschinengröße (L × B × H)	1,1 m × 2,4 m × 1,6 m		
Stellplatzkapazität	90 × 8 mm Stellplätze		
Bestückköpfe	Bestückkopf CP20, Bestückkopf CPP, Bestückkopf TWIN, Bestückkopf TWIN VHF		
Transport	Einzeltransport, flexibler Doppeltransport		
Bauelementespektrum	016008M bis 200 mm × 150 mm × 28 mm		
Leiterplattenformat (L × B)	850 mm × 610 mm Einfachtransport 700 mm × 530 mm Doppeltransport (im Einfachtransportmodus) 400 mm × 280 mm Doppeltransport (im Doppeltransportmodus)		
Bauelementezuführung	Tapes, Trays		

Bestückkopf	Bestückkopf CP20	Bestückkopf CPP	Bestückkopf TWIN
Bauelementespektrum	016008M bis 8,2 × 8,2 mm	01005 bis 50 mm × 40 mm	0402 bis 200 mm × 150 mm
Maximale Bauelementhöhe	2 mm oder 4 mm	15,5 mm	28 mm
Bestückgenauigkeit	25 μm @ 3 σ	25 μm @ 3 σ	20 μm @ 3 σ
Maximale Bestückleistung	52.500 BE/h	28.000 BE/h	6.000 BE/h
Bestückkraft	4,5 N	15 N	100 N



ASMPT GmbH & Co. KG Rupert-Mayer-Straße 48 | 81379 München | Deutschland | Telefon: +49 89 20800-22000 | Email: smt-solutions.de@asmpt.com





ASMPT SMT Solutions Website

smt.asmpt.com



ASMPT Website

asmpt.com



ASMPT SMT Solutions LinkedIn

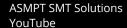
www.linkedin.com/ company/ asmpt-smt-solutions/



ASMPT SMT Solutions Facebook

www.facebook.com/ ASMPTSMTSolutions





•

www.youtube.com/c/ ASMPTSMTSolutions

Ausgabe 1/11-2025 | Änderungen vorbehalten | Bestell-Nr.: A22-ASMPT-A378 | Gedruckt in Deutschland | © ASMPT GmbH & Co. KG

Alle Informationen und Abbildungen in dieser Broschüre werden "wie besehen" und ohne ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung jeglicher Art zur Verfügung gestellt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Garantien von zufriedenstellender Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck und/oder Richtigkeit.

Die Inhalte dieser Broschüre dienen nur der allgemeinen Information, stellen keine Beratung dar und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. ASMPT gibt daher keine Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf die Verwendung der in dieser Broschüre enthaltenen Inhalte, Details, Spezifikationen oder Informationen hinsichtlich deren Richtigkeit, Genauigkeit, Angemessenheit, Nützlichkeit, Aktualität, Verlässlichkeit oder Sonstiges; dies in jedem Fall im größtmöglichen Umfang, der rechtlich zulässig ist. Bitte wenden Sie sich an ASMPT, um die aktuellsten Informationen zu erhalten. Besondere Leistungsmerkmale und/oder Fähigkeiten sind nur dann bindend, wenn sie vertraglich vereinhart wurden

Alle Produktnamen sind Marken oder Warenzeichen von ASMPT oder anderen Anbietern. Die unbefugte Verwendung durch Dritte kann die Rechte ihrer Eigentümer verletzen.